

# 第20回 有機/無機接合研究委員会

日時：2024年3月15日（金）13:00～15:50  
場所：東京理科大学 野田キャンパス（千葉県野田市）

## プログラム

---

司会 浅井 竜彦（富士電機(株)）

**13:00～13:10** 委員会議事

**13:10～13:40**

『高 Tg モールド樹脂を適用した高耐熱パワーモジュールパッケージの検討』（30分）  
..... ○西原 孝太郎、小杉 祥、塙 勇太郎、鹿野 武敏（三菱電機(株)）

**13:40～14:20**

『FPC を用いた超薄型高圧電源の開発』（40分）  
..... ○指田 和之（新電元工業(株)）

14:20～14:30 休憩

司会 藤田 晶（化研テック(株)）

**14:30～15:10**

『金属-樹脂接合の界面構造と接合メカニズム』（40分）  
..... ○堀内 伸（産業技術総合研究所）

**15:10～15:50**

『微小柱せん断試験によるエポキシ接着剤の接着強度評価』（40分）  
..... ○山崎 泰広（千葉大学）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

---

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。  
※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。  
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会